



## 華立去年財報亮眼 全年合併毛利、營業利益同創史上新高

2026.03.11 高科技材料設備供應商華立（3010）11日董事會通過2025年財報，全年合併稅後淨利26億元，每股盈餘8.84元。受惠人工智慧應用快速擴展，AI伺服器、高效能運算與先進半導體需求持續增溫，帶動半導體、電子材料及設備供應鏈維持穩健成長。此一趨勢延續至今年，華立前兩月累計營收創歷史新高，2月營收亦在春節工作天數減少下，仍創同期新高，顯示終端需求動能強勁。

華立董事會同時通過去年盈餘分配案，擬每股配發5.3元現金股利，長期穩定配息政策深受價值型投資人關注。面對全球經濟環境波動，公司持續強化風險控管與營運品質管理，透過優化客戶組合及建立更嚴謹的風險預警機制，將資源聚焦於高附加價值與高成長潛力業務。2025年全年合併營收781.9億元，營收規模略為調整，但獲利結構明顯優化，全年合併毛利63.1億元、營業利益31.2億元雙創歷史新高，稅前淨利34.5億元亦為近四年高點。

在半導體領域方面，華立主要客戶受AI與高效能運算（HPC）需求持續強勁帶動，營收預期年增近30%，並大幅提高資本支出，投資規模創歷史新高，重點布局先進製程與先進封裝產能。市場指出，多座興建中的先進產能已獲終端客戶提前預訂，顯示AI相關需求之強勁。

受惠此一產業趨勢，華立身為關鍵材料供應商，光阻、研磨液、先進封裝材料及電子級特殊氣體等產品出貨暢旺，帶動半導體材料相關營收呈現高雙位數成長。此外，客戶於去年底導入量產的最新製程節點，將於2026年進一步放量，由於華立在該製程材料已取得領先市占，預期將持續挹注半導體材料事業成長動能，成為公司未來營運的重要成長引擎。

在ABF載板產業方面，本波由AI所帶動的上行循環，與過去由PC等消費性電子需求主導的景氣循環不同，不僅需求波動較小、能見度也相對提升。隨著AI GPU、ASIC晶片及高速運算需求持續升溫，ABF載板不僅出貨量增加，在更大尺寸與更高層數的技術要求下，需求量明顯激增。華立引進的高解析度乾膜成功取得多家指標客戶主要訂單，帶動相關產品營收呈現高雙位數成長。

在PCB市場方面，華立大力布局低軌衛星應用。由於衛星電路板須承受高低溫循環、強震動與長時間運作環境，對材料與製程要求極高。華立銷售的高解析度乾膜攻入低軌衛星板核心供應鏈。隨著客戶於泰國擴大產能布局，華立亦同步將供應版圖延伸至東南亞市場。在國際業者積極部署衛星商機的趨勢下，推動華立相關材料營收一路向上增長。

另一方面，雲端服務業者（CSP）持續提高資本支出，AI訓練與推論所需專用晶片需求快速攀升，高階銅箔基板供不應求。華立在原廠全力支持下，已成功打入全球多家



主要伺服器 PCB 製造商供應鏈。受惠 AI 伺服器訂單暢旺及 800G 交換器新產能陸續開出，今年前兩月銅箔基板相關業務營收已呈現倍數成長。未來公司將持續拓展客戶群與增加新開發案，預計迎來更多訂單，搭上這波 AI 需求爆發的浪潮。

此外，隨著 AI 需求帶動記憶體產業升級，主要記憶體廠商逐步停產 DDR4 產品，將產能轉向 DDR5 與高頻寬記憶體（HBM）等先進製程，造成 DDR4 供應趨緊、價格上揚。華立銷售的高機能工程塑膠具備優異耐熱性能，為 DDR 插槽連接器關鍵材料，客戶涵蓋全球前三大 DDR 插槽連接器製造商。隨著 DDR4 市場出現供需吃緊、價量齊揚態勢，亦將帶動華立相關材料業績持續成長。



**關於華立企業：**本公司成立於 1968 年，配合我國工業發展與整體企業營運需求，先後引進複合材料、資訊/通訊、印刷電路板、半導體、平面顯示器、以及綠能光電產業材料與設備，以致力成為大中華地區提供高科技材料、設備與技術的全方位科技服務廠商。華立企業總公司位於高雄，先後於中國大陸、新加坡、韓國等重要城市設立銷售據點。

新聞聯絡人：

呂淑甄

投資人關係

華立企業股份有限公司

Tel. +886-7-2164311, ext. 27093

Email : [jessica@wahlee.com](mailto:jessica@wahlee.com)

Website : [www.wahlee.com](http://www.wahlee.com)